**中国传感器与物联网产业联盟**

**会员申请表**

|  |
| --- |
| **单位具体信息**（\* 为必填项目） |
| \* 单位名称 |  |
| \* 单位地址 |  |
| \* 单位网址 |  |
| 法人或负责人 | \* 姓名 |  | \* 电话 |  |
| \* 职务 |  | \* 手机 |  |
| \* E-mail |  |
| 联系人 | \* 姓名 |  | \* 电话 |  |
| \* 职务 |  | \* 手机 |  |
| \* E-mail |  |
| \* 经济性质 | □国有 □外资 □合资 □民营 |
| \* 年度营业额 | □1000万以下 □1000-3000万 □3000-5000万 □5000-7000万 □7000万-1亿 □1亿以上 |
| 公司简介（核心技术、产品、业务）200-300字 |  |
| \* 申请会员类别 | □ 理事会员 □普通会员  |
| 对联盟工作的建议和需求 |  |
| **产业领域**（请标注出在贵单位所处技术领域及产业链环节，可多选） |
| □ 高校、科研院所 | □ 行业协会、组织 |
| □ 半导体 | □ 消费类 | □ 航空航天 | □ 家电 |
| □ 工业 | □ 汽车 | □ 农业 | □ 医疗 |
| □ 通讯 | □ 建筑 | □ 教育及培训 | □ 金融 |
| □ 媒体 | □ 能源 | □ 服务（展会/律行/咨询机构/孵化器） |
| 其它产业领域： | *请填写* |
| **产业链分工**（半导体产业领域企业请标注出贵单位所处产业链分工，可多选） |
| □ IDM | □ 半导体设备 | □ 半导体材料 | □ 芯片设计 |
| □ 晶圆制造 | □ 封装测试 | □ 系统集成 | □ 芯片代理 |
| □ 其他 | *请填写* |
| **专委会**（请标注出贵单位所感兴趣的专委会，可多选） |
| □ 智慧环境/水务 | □ 智联交通 | □ 工业互联网 | □ 工业传感器 |
| □ 成果转化 | □ 光电技术 | □ 智慧生活 | □ 信息安全 |
| □ 智慧农业 | □ 汽车电子 | □ 科学仪器 | □ 产学研 |
| □ 传感器封测技术 | □ 物联网智能无线网络通信 |
| □ 健康医疗传感与应用 | □ 能源工业传感器与应用技术 |
| □ 其他 | *请填写* |
| **服务需求（请标注出贵单位所需要的服务，可多选）** |
| □ 人才培训 | □ 咨询服务 | □ 融资对接 | □ 对接服务 |
| □ 专利申请 | □ 媒体采访 | □ 宣传推广 | □ 展会/会议 |
| □ 其他 | *请填写* |
| **感兴趣的行业领域（可多选）** |
| □ 能源 | □ 智能制造 | □ 环境监测 | □ 汽车产业链 |
| □ 航空航天 | □ 智慧农业 | □ 医疗器械 | □ 家电产业链 |
| □ 船舶海工装备 | □ 城市基础建设 | □ 其他 | *请填写* |
| 注：请用正楷字体填写，将填好的登记表加盖公章扫描发送email至联盟秘书处 |
| 申请单位公章处或负责人签字（我单位自愿加入本联盟，拥护联盟章程，执行联盟权利与义务） |
| 本单位LOGO，请另外附件\*联盟保留条款最终解释权 |

**联盟秘书处联系人：戴 英丨18913138557**

**联盟秘书处联系人：戴夏萍丨13671501968**

**联盟秘书处邮件：SIA@si-wave.net**

**地址：上海市嘉定区皇庆路333号，201800**

**官网：**[**www.sensors-iot.net**](http://www.sensors-iot.net)